



2026年3月19日

各位

会社名 株式会社RS Technologies  
代表者名 代表取締役社長 方 永義  
コード番号 3445 東証プライム市場  
問合せ先 執行役員 経営企画部長 田渕 勝也  
電話 03-5709-7685

## 中国における子会社設立のお知らせ

当社は、中国連結子会社である有研半導体硅材料股份公司（以下、GRITEK）が、中華人民共和国内モンゴル自治区に子会社「国晶半導体材料（包頭）有限公司（仮称）」を設立することを本日開催の董事会において決議いたしましたことを、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設立の目的

当社は、中国におけるプライムウェーハ製造販売事業への参入を目的として、2018年1月にM&AによりGRITEKを連結子会社化いたしました。同年8月には、当社及びGRITEKの合弁会社として山東有研半導体材料有限公司（以下、山東GRITEK）を設立し、新たに建設した山東省のメイン工場にて、8インチプライムウェーハ製造販売事業を中心に展開してまいりました。

当該子会社では、シリコンウェーハの単結晶及びエッチング装置の消耗部材用の大口径単結晶を生産する単結晶工場を建設する予定です。GRITEKと連携することで、当社グループのさらなる生産能力の向上と競争力強化を図ることができると判断し、この度、子会社新設を決定いたしました。

立地の選定にあたっては、現在拠点がある北京市、徳州市と比較して、電気料金をはじめとするインフラコストの削減が可能となる点が決定の理由となりました。

本件に関する具体的な投資及び事業計画につきましては、決定次第速やかに開示いたします。

## 2. 新設する子会社「国晶半導体材料（包頭）有限公司（仮称）」の概要

(1) 名 称	国晶半導体材料（包頭）有限公司（仮称） <sup>※1</sup> （英語名：Guojing Semiconductor Materials (Baotou) Co., Ltd.）	
(2) 所 在 地	中華人民共和国 内モンゴル包頭稀土高新技術産業開発区	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 張 果虎	
(4) 事 業 内 容	単結晶シリコンおよび大口径単結晶シリコンの製造、販売業務	
(5) 登 録 資 本 <sup>※2</sup>	400百万人民元（約9,084百万円 <sup>※3</sup> ）	
(6) 出 資 比 率	有研半導体硅材料股份公司：100%	
(7) 設 立 年 月 日	2026年4月（予定）	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	有研半導体硅材料股份公司：100%
	人的関係	当社の従業員が董事を兼任する予定であります。
	取引関係	該当事項はありません。

※1. 商号は中国当局に申請予定

※2. 契約スケジュールに従い、段階的に出資していく予定であります。

※3. 1 RMB=22.71JPYで換算

## 3. 出資会社の概要

### 【有研半導体硅材料股份公司について】

(1) 名 称	有研半導体硅材料股份公司 （英語名：GRINM Semiconductor Materials Co., Ltd.）	
(2) 所 在 地	中華人民共和国 北京市西城区新街口外大街2号	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 方 永義	
(4) 事 業 内 容	シリコンウェーハ及び CZインゴット・FZインゴットの製造、販売、開発、関連技術の開発等	
(5) 資 本 金	1,250百万人民元（2025年12月末時点）	
(6) 設 立 年 月 日	2001年6月21日（2018年1月当社連結子会社化）	
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が直接保有、間接保有合わせて40.85%出資しております。
	人的関係	当社の役員と従業員が董事を兼任しています。
	取引関係	該当事項はありません。

## 4. 業績に与える影響

2026年12月期連結業績に与える影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上